

证券代码：603061

证券简称：金海通

公告编号：2024-027

## 天津金海通半导体设备股份有限公司

### 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

回购方案首次披露日	2024/1/24
回购方案实施期限	2024年1月23日~2024年4月22日
预计回购金额	13,000万元~20,000万元
回购价格上限	75元/股
回购用途	<input type="checkbox"/> 减少注册资本 <input checked="" type="checkbox"/> 用于员工持股计划或股权激励 <input type="checkbox"/> 用于转换公司可转债 <input checked="" type="checkbox"/> 为维护公司价值及股东权益
实际回购股数	242.3970万股
实际回购股数占总股本比例	4.04%
实际回购金额	16,595.11882万元
实际回购价格区间	60.21元/股~74.98元/股

#### 一、回购审批情况和回购方案内容

天津金海通半导体设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月23日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。此外，公司于2024年2月1日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于变更以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，并于2024年

2月2日披露了《天津金海通半导体设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。根据《公司章程》第二十五条的规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

回购股份方案的主要内容如下：公司拟使用自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购资金总额不低于13,000万元（含）且不超过20,000万元（含），本次回购股份的45%（以本次回购完成后具体回购的股份总数为计算基准）拟用于员工持股计划或股权激励，其余拟在披露回购结果暨股份变动公告12个月后采用集中竞价交易方式出售。针对拟出售的部分，如公司后续有员工持股计划或股权激励的用途，亦可以考虑将回购的股份用途调整为员工持股计划或股权激励。本次回购股份的价格为不超过人民币75元/股（含），回购期限为自第二届董事会第二次会议审议通过变更前的回购股份方案之日起不超过3个月。

具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-008）。

## 二、 回购实施情况

（一）2024年2月1日，公司首次实施回购股份，并于2024年2月2日披露了首次回购股份情况，详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津金海通半导体设备股份有限公司关于以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：2024-009）。

（二）2024年4月22日，公司本次回购股份期限已届满，已实际回购公司股份242.3970万股，占公司总股本的4.04%，回购最高价格74.98元/股，回购最低价格60.21元/股，回购均价68.46元/股，使用资金总额16595.11882万元（不含交易费用）。

（三）回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

（四）本次股份回购不会对公司日常生产经营、财务状况、债务履行能力、盈利能力和未来发展产生重大不利影响。基于对公司未来持续发展的信心和对公司

价值的认可，综合考虑目前经营情况、财务状况、未来盈利能力等因素，不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位。

### 三、 回购期间相关主体买卖股票情况

截至本公告披露前，公司董监高、控股股东及其一致行动人、实际控制人在此期间不存在买卖公司股票的情况。

### 四、 股份变动表

本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

股份类别	回购前		回购完成后	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件流通股	45,000,000	75.00	18,173,666	30.29
无限售条件流通股	15,000,000	25.00	41,826,334	69.71
其中：回购专用证券账户	0	0.00	2,423,970	4.04
股份总数	60,000,000	100.00	60,000,000	100.00

### 五、 已回购股份的处理安排

公司本次总计回购股份 2,423,970 股，其中回购股份的 45%拟用于员工持股计划或股权激励之用途，其余拟在披露回购结果暨股份变动公告 12 个月后采用集中竞价交易方式出售。针对拟出售的部分，如公司后续有员工持股计划或股权激励的用途，亦可以考虑将回购的股份用途调整为员工持股计划或股权激励，公司将就后续调整事项（如有）及时履行相关的审议程序及信息披露义务。

特此公告。

天津金海通半导体设备股份有限公司

董事会

2024年4月23日